



2026年3月18日

株式会社 F U J I

ファスフォードテクノロジー株式会社

FUJI グループのファスフォードテクノロジー、半導体製造装置の 次世代ダイボンダ『XERDIA』を SEMICON China 2026 にて世界初公開

株式会社 F U J I (本社: 愛知県知立市、代表取締役社長: 五十棲 丈二、以下「FUJI」) のグループ会社で、半導体製造装置を開発・製造・販売するファスフォードテクノロジー株式会社 (本社: 山梨県南アルプス市、代表取締役社長: 粟生 浩之、以下「ファスフォードテクノロジー」) は、開発を進める次世代フラッグシップダイボンダ『XERDIA (ゼルディア)』を 2026年3月25日(水) ~ 27日(金) に上海で開催される SEMICON China 2026 において、世界で初めて公開いたします。

XERDIA

XERDIA



SEMICON China 2026 展示予定機

「ダイボンダ」とは、電子回路が集積した半導体チップ (=ダイ) を基板に接着 (=ボンディング) する半導体後工程装置です。近年の半導体分野では、半導体の高機能化や記憶容量の大容量化に伴い、複数のダイを高密度で実装する先端パッケージ技術の重要性が高まっています。このような高密度実装では、ダイのわずかな位置ずれが信頼性に大きく影響するため、高精度なダイボンディング技術が不可欠です。また、生成 AI をはじめとするデータ処理需要の拡大により、データ量が爆発的に増加し、それを支えるデータセンターや AI 関連機器の普及に伴ってメモリを中心とした半導体需要が拡大しています。これにより、半導体製造工程では高精度に加えて、より高い生産性への要求も高まっています。

ファスフォードテクノロジーは、こうした市場ニーズに対応するため、『XERDIA』を開発しました。

『XERDIA』は、従来の DB830/DB850 シリーズの設計思想を継承しながらも、**装置筐体・基幹ユニット・ハード/ソフトを含む制御プラットフォーム**を全面的に刷新することで、**ボンダ精度***を 5 μ m から 3 μ m へ向上させるとともに、**生産性***を UPH 4,000 から 5,500 へと飛躍的に高めた次世代モデルです。また DB シリーズで培った操作性を継承し、高機能でありながらユーザフレンドリーな操作性を両立しています。

※当社標準設定による。

■ 4つの開発コンセプト

ファスフォードテクノロジーは、市場ニーズに応える次世代ダイボンドの開発にあたり、“**次世代量産装置の新たな業界基準をつくる**”ことを目指し、次の4つの開発コンセプトのもとで『XERDIA』を開発しました。

1. 安定稼働 | “止まらない”

高剛性筐体による振動低減(従来比 50%)と刷新された基幹ユニットにより、従来から定評のある高い安定稼働率を更に向上。

2. 生産準備工数の低減 | “手間がかからない”

新制御プラットフォームによる操作性向上と、ツール自動交換機能やワーク押えのユニバーサル化により段取り効率・保守性を**最大 34%改善**。

3. 既存設備資産の有効活用 | “コスパがいい”

DB シリーズの資産(ツール、レシピ)活用を最大化することで、**初期投資の最小化を実現**。

4. 環境負荷の低減 | “環境にやさしい”

面積生産性の最大化(従来比 30%改善)と、新制御プラットフォームによるエネルギー効率改善で**装置スタンバイ時消費電力を 13%低減**、更に ECO モード 2.0 により**装置アイドル時消費電力を 26%削減**し、環境負荷を低減します。

■ FUJI グループ参入後、初の新規開発製品

『XERDIA』は、2018年にファスフォードテクノロジーが **FUJI グループ** となって以降、**初めてゼロから開発した装置**です。同じくグループ会社である FUJI リニア(株)製リニアモータの採用や、FUJI デザインチームと共同で手掛けた装置デザインなど、FUJI グループの技術シナジーを活かした新しい設計思想の結晶となっています。

■ SEMICON China 2026 での展示情報

2026年3月25日(水)~27日(金)の会期中、ファスフォードテクノロジーの中国代理店 JIPAL Corporation のブース (N4 ホール/ブース番号 4151) にて開発中の『XERDIA』実機を参考展示し、本展示を通じて得られる市場からのフィードバックを今後の製品開発に反映してまいります。

また、FUJI は、同展示会「E4 ホール/ブース番号 4342」にて、SMT 工程[※]における段取り替えや部品供給の自動化を実現する電子部品実装ロボット『NXTR』をはじめ、自動化ソリューションを多数展示する予定です。

※電子回路基板への部品実装工程

■ 今後の予定

製品化スケジュール

『XERDIA』の正式なリリースは **2026年6月を予定**しています。

ファスフォードテクノロジーは、本開発を通じて、最先端パッケージ分野への対応力を強化し、新たな市場価値の創出を目指してまいります。また、今後も FUJI グループの技術シナジーを活かし、半導体製造分野における技術革新に貢献してまいります。

■会社概要

ファスフォードテクノロジーについて

会社名 : ファスフォードテクノロジー株式会社
代表者 : 代表取締役社長 粟生 浩之
所在地 : 〒400-0212 山梨県南アルプス市下今諏訪 610-5 番地
設立 : 2015年3月
事業内容 : 半導体製造装置の設計、製造、販売、修理及び保守等のサービス業
資本金 : 450.5百万円
URL : <https://www.fasford-tech.com/>

F U J I について

会社名 : 株式会社 F U J I
代表者 : 代表取締役社長 五十棲 丈二
所在地 : 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山 19
設立 : 1959年4月
事業内容 : 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売
資本金 : 5,878百万円
URL : <https://www.fuji.co.jp/>

■本件に関するお問合せ先

ファスフォードテクノロジー株式会社 ウェブお問い合わせフォーム
<https://www.fasford-tech.com/contact/>